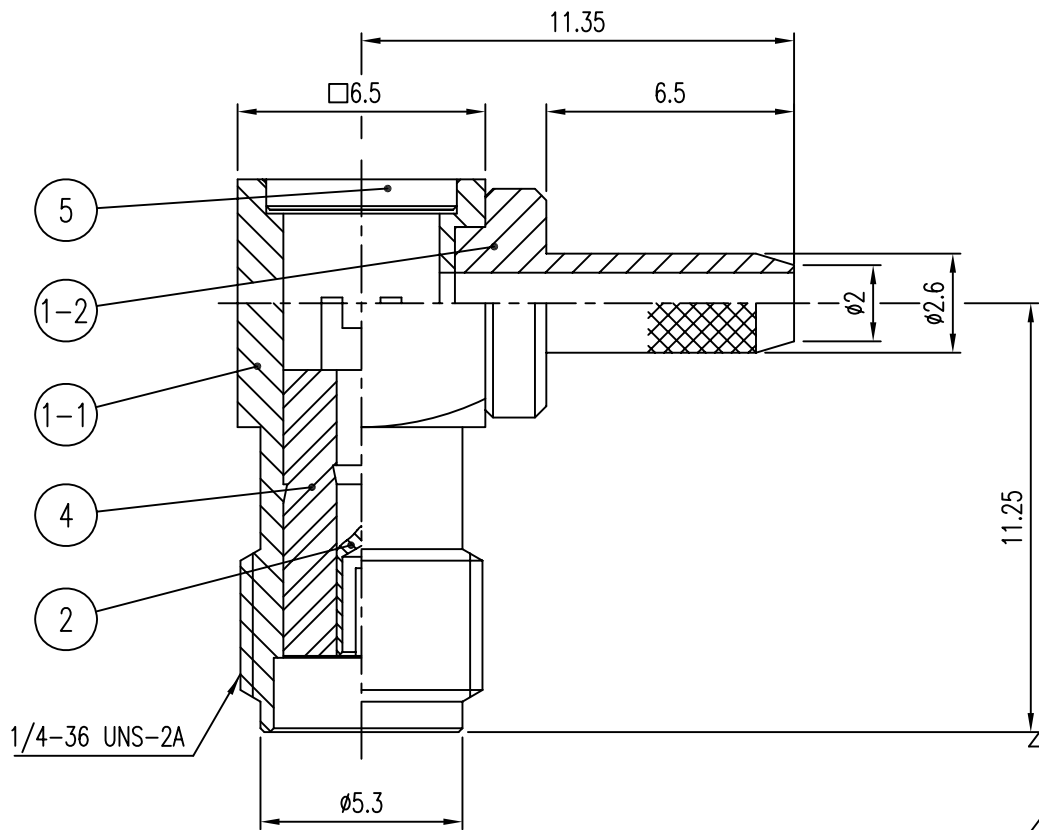


수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
1	[실변제리No.201806-0001] Cover 등용 및 비정성적으로 연착되는 원상으로 인한 Cover CODE 변경	김찬경	김인철	2016.	06.	09.			
2	[실변제리No.201806-0001] 조립성 개선으로 인한 배선 위치바늘 추가 및 배선표준화	은선영	김인철	2018.	06.	04.			
3	[실변제리No.202203-0008] PCB 공용화 부품 적용으로 인한 코드 변경	은선영	김선호	2022.	03.	15.			



5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00026-5/2 DCO00031-5/1 (4-2013)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00090-N/1 (H2019)
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate Gold Plate	DFE00034-5/1 DFE00031-145/1 (4-2002)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00157-1345/1 (E2196)
1-2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01284-3/1
1-1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00208-5/1 DBD00224-3/1

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질		표면처리		비 고	
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일 2022. 03. 15.					 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.					
	승인		S. H. KIM								
	재질	검도					도명 SMA-LJC-316				
	재도		S. Y. EUN								
열처리	작성부서 연 구 소					A4도번 CN00129-7/2					
보호피막처리	척도 5/1		단위 mm		종량						